

Title (en)

ELECTROLYTE SOLUTION AND PROCESS FOR HIGH SPEED GOLD PLATING.

Title (de)

ELEKTROLYTLÖSUNG UND VERFAHREN ZUR SEHR SCHNELLEN GOLDPLATTIERUNG.

Title (fr)

SOLUTION D'ELECTROLYTE ET PROCEDE DE DORURE ELECTROLYTIQUE A HAUTE VITESSE.

Publication

EP 0261203 A1 19880330 (EN)

Application

EP 87902236 A 19870302

Priority

US 83624086 A 19860305

Abstract (en)

[origin: WO8705339A1] In the electrodeposition of gold by electrolyzing an aqueous solution containing potassium gold cyanide, the improvement which comprises including in the solution a critical concentration of formic acid, a phosphonic acid type chelating agent and a cobalt or nickel compound, at a critical pH, to achieve extremely rapid plating speeds. Relatively high plating temperatures in the range of about 90 DEG to 160 DEG F and high current densities ranging up to about 1000 ASF may be used to achieve fast plating speeds without degradation of the quality of the deposit.

Abstract (fr)

Dépôt électrolytique d'or par électrolyse d'une solution aqueuse contenant du cyanure d'or de potassium, comprenant une concentration critique d'acide formique, d'un agent de chélation du type acide phosphonique et d'un composé de cobalt ou de nickel, à un pH critique, pour obtenir des vitesses de placage extrêmement élevées. On peut utiliser des températures de placage relativement élevées, dans la gamme comprise entre 90° et 160°F et des intensités de courant élevées allant jusqu'à 1000 ASF, de manière à atteindre des vitesses de placage élevées sans dégradation de la qualité du dépôt.

IPC 1-7

C25D 3/50; **C25D 3/58**

IPC 8 full level

C25D 3/48 (2006.01); **C25D 3/62** (2006.01)

CPC (source: EP)

C25D 3/48 (2013.01); **C25D 3/62** (2013.01)

Citation (search report)

See references of WO 8705339A1

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)

WO 8705339 A1 19870911; EP 0261203 A1 19880330

DOCDB simple family (application)

US 8700513 W 19870302; EP 87902236 A 19870302